

MT18Ex

- ・ Micro Thin は18 μ mのキャリア銅箔が付いている極薄銅箔です。
Micro Thin is ultra thin foil with 18 μ m carrier foil.
- ・ 微細回路形成に有効で、L/S=20/20~35/35の回路形成が可能です。
Usable for fine pitch pattern L/S=20/20 - 35/35 formation.
- ・ MT18SD-Hに比べ、粗化処理面の粗さが低く、より微細回路形成に適しています。
Lower profile compare with MT18SD-H, more suitable for very fine pattern.

用途/Application

- ・ 半導体パッケージ基板
/Semiconductor Package
- ・ 多層プリント配線板
/High Density Interconnect

構成/Composition



生産拠点/Production Site

- ・ 日本 / Japan
- ・ マレーシア / Malaysia

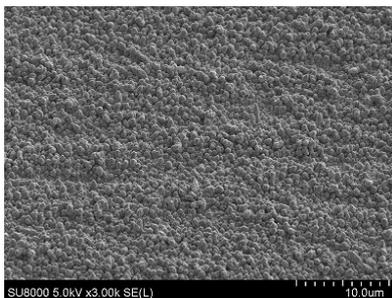
代表的特性値/Representive date

	μ m	Area weight (g/m ²)	Laminate side Rz(μ m)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elogation (%)	Peel Strength (kg/cm)@FR-4
MT18Ex	1.5	20	2	-	-	1.2
	2	24	2	-	-	1.2
	3	33	2	-	-	1.2
	5	51	2	-	-	1.2

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative date, not guarantee.

※Peel Strength は、35 μ mまでメッキアップした後の測定値
Evaluated after plated up to 35 μ m

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

